



郵便はがき



## 株主通信

第22期上半期

自2023年4月1日 至2023年9月30日



株式会社ジエダット <証券コード：3841>

当冊子に関するお問合せ先

株式会社ジエダット 経営企画部  
東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 Tel : 03-6262-8400 (代)  
E-mail : corporate.planning1@jedat.co.jp

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

## JEDAT Solution Seminar 2023 開催

2023年8月30日（京都会場）、9月1日（東京会場）の2日間、プライベートショー「JEDAT Solution Seminar 2023」を開催いたしました。4年ぶりの東西会場におけるリアル開催となった今回のセミナーには、基調講演に株式会社産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉様、招待講演にキオクシア株式会社 SSD事業部 理事 大島 成夫様、特別講演に東北大学 教授 遠藤 哲郎 様をお迎えし、業界最先端のご講演をいただきました。エイブリック株式会社様、三菱電機株式会社様によるユーザー事例の他、SX-Meisterのロードマップや国内外の新製品のご紹介は、多くのお客様に好評をいただいております。

## 株式数及び株主数 (2023年9月30日現在)

発行可能株式総数	7,800,000 株
発行済株式総数	3,909,800 株
株主数	908 名

## 株主メモ

上場市場	東京証券取引所 スタンダード市場
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
事務取扱場所	みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 <a href="https://www.jedat.co.jp/">https://www.jedat.co.jp/</a>
	ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載します。

## 会社概要 (2023年9月30日現在)

商号	株式会社ジエダット (Jedat Inc.)
所在地	〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
代表者	代表取締役社長 松尾 和利
営業開始	2004年2月2日
資本金	762,524,260 円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルティング

# 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2024年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当第2四半期累計期間における売上高は、国内顧客の設備投資の延期、並びに第1四半期のFPD顧客向けの売上減少の影響を受け8億85百万円（前年同四半期比9.2%減）となり、営業利益は85百万円（前年同四半期比36.8%減）となりました。経常利益は、円安による為替差益等の計上により、1億35百万円（前年同四半期比24.7%減）となり、四半期純利益は外国税額控除等による税金費用の減少により1億33百万円（前年同四半期比13.1%減）となりました。

当第2四半期累計期間における、当社の主要顧客である電子部品業界は、地政学的リスクからのサプライチェーンの強化を目的に、政府からの助成金などによる半導体設備の投資が旺盛な状況です。また、スマートフォンやパソコンなどの需要低迷によるメモリーの在庫調整が進みようやく生産調整の出口が見えつつあります。FPD（Flat Panel Display）市場はスマートウォッチやヘッドマウントディスプレイ等に用いられるマイクロLEDの需要が漸増するものの、テレビ向けの大型パネルおよびパソコン向けの中小型パネルは、生産調整が続いている状況ですが、FPD市場もようやく出口が見え始めております。

このような状況の中、当社はアナログ半導体向け設計環境の効率化を追求し続けており、主力製品であるSX-MeisterのアナログLSIの設計自動化に向けたACC（Analog Chip Compiler）製品の開発力を強化しました。さらに4年ぶりの対面形式のプライベートセミナーを開催し、SX-MeisterにAIを導入する開発計画、ACCそしてパワー半導体向けソリューションの最新機能を紹介しました。さらに競争力のある代理店製品を拡充し、それらを活用した営業活動を積極的に展開しております。海外市場への販売活動においては、大規模フォトマスクブラウザ：HOTSCOPEの拡販に注力した結果、売上比率を伸ばしました。ソリューション・ビジネスにおいては、国内の設計委託の活発な需要を受け、売上は堅調に推移しました。

当下半期におきましても、大学・高専・企業との連携を強化し、主力製品の更なる機能強化に努めてまいります。また、新規リリース製品及び、新規代理販売品の獲得により、製品・サービスの領域を拡大し、並行して積極的な情報発信活動を行うなど精力的に販促活動を進めてまいります。

株主の皆様におかれましては引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

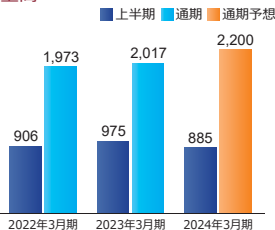
松尾和利

## 第2四半期累計期間 売上高 (単位:百万円)

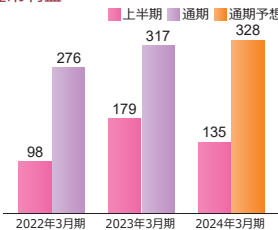
		2023年3月期	2024年3月期		
		実績	期初計画	実績	前年同期比
事業別売上高	製品	556	644	486	△12.6%
	サービス	208	210	208	△0.3%
	ソリューション	210	190	191	△8.8%
市場別売上高	半導体市場	696	775	663	△4.7%
	FPD市場	278	268	222	△20.2%
製品区分別売上高	自社開発製品	794	835	723	△8.9%
	代理販売製品	181	208	162	△10.4%
売上高合計		975	1,044	885	△9.2%

## 財務ハイライト (単位:百万円)

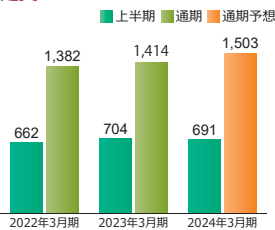
### 売上高



### 経常利益



### 固定費



### 総資産・自己資本

